

行业及产业

电子

MLCC 或迎来涨价周期

——电子行业跟踪报告

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业跟踪报告：字节跳动发布 Seedance 2.0》2026-02-24
- 《电子行业跟踪报告：摩尔线程推出智能编程服务》2026-02-09
- 《电子行业周报：AI 算力需求爆发，带动半导体设备、存储赛道景气度上行》2026-02-03
- 《电子行业跟踪报告：OpenClaw 助力 AI Agent 技术范式升级》2026-02-03
- 《电子行业周报：Intel 25Q4 服务器与人工智能业务增长亮眼》2026-01-26

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- 本周（2026/2/23-3/1）SW 电子行业指数（+4.07%），涨跌幅排名 13/31 位，沪深 300 指数（+1.08%）。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：钢铁（+12.27%），有色金属（+9.77%），基础化工（+7.15%），环保（+6.96%），煤炭（+5.92%），涨跌幅后五分别为：传媒（-5.10%），商贸零售（-1.64%），食品饮料（-1.54%），非银金融（-1.18%），银行（-0.92%）。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板（+12.78%），被动元件（+10.48%），半导体材料（+7.47%），涨跌幅后三分别是：集成电路制造（-1.08%），品牌消费电子（-0.54%），模拟芯片设计（+1.45%）。
- **事件：**AI 带动的元器件涨价周期已从存储向核心被动元器件环节延伸。据韩国 The Elec 2026 年 2 月 24 日报道，全球重要 MLCC（多层陶瓷电容）厂商三星电机，正评估旗下产品的定价上调计划。MLCC 是电子电路中负责滤波、稳压、储能的核心基础元器件，韩国《Maeil Business Newspaper》分析指出，AI 服务器迭代带来的结构性高需求，是本轮 MLCC 涨价预期的核心支撑。
- **MLCC（多层陶瓷电容器）是目前全球电子整机领域应用最广、用量最大的片式固定电容器。**它通过将印有内电极的陶瓷介质膜片交替错位层叠，经高温共烧成型后，在两端封接金属端电极制成。MLCC 因具备容体比大、结构致密、介质损耗小等核心优势，被广泛用于各类电子整机的旁路、滤波、耦合等核心电路环节，覆盖消费电子、汽车电子等领域。粉体网数据显示，MLCC 成本主要由陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料、人工成本、设备折旧及其他构成。其中陶瓷粉料在 MLCC 的成本中占比较大，尤其在 high-cap MLCC 中成本占比可达 35%-45%。
- **全球 MLCC 涨价周期有望延续至 2026 年。**中国电子元件行业协会数据显示，受益于消费电子需求回暖与新能源汽车高渗透率双重驱动，2024 年全球 MLCC 市场规模 1006.1 亿元，其中国市场规模为 528.4 亿元。2025 年在 AI 服务器、车规级 MLCC 需求拉动下，全球市场规模预计达 1050.43 亿元，同比增长 4.4%。竞争格局方面，全球市场仍由日韩企业主导，2024 年按金额口径 CR5（村田、三星电机、太阳诱电、TDK、京瓷）合计占比 77.3%。结合村田、国巨、风华高科 2016Q1-2025Q3 季度毛利率数据来看，2016-2019 年行业受日韩厂商产能退出带动盈利提升，后随扩产过剩景气回落；2020-2023Q1 在 5G 通信、新能源汽车等需求驱动下景气再度上行，2024H2 起三家公司毛利率整体呈上升趋势。当前下游 AI 算力需求持续高景气，行业供需格局持续优化，2026 年 MLCC 市场涨价周期有望延续。
- **风华高科是国产 MLCC 重要厂商。**公司产品广泛覆盖汽车电子、AI 算力、新能源、工业控制等多元高景气赛道。自 2023 年起，风华高科营业收入保持稳步增长态势。2024 年公司实现营业收入 49.39 亿元，同比增长 17.00%。2024 年公司综合毛利率达 19.17%，同比提升 4.82 pct。同时，公司持续加码研发投入，在车规 MLCC、高端元器件、上游关键材料三大领域实现核心技术突破。产能端，公司精准锚定高端赛道动态优化布局，在推动祥和工业园高端 MLCC 基地产能稳步释放的同时，主动缩减低端通用型 MLCC 产能投资，集中资源聚焦高端化转型。
- **投资建议：**AI 算力等下游需求维持高景气，有望驱动 MLCC 行业开启新一轮景气周期，建议重点关注风华高科（000636.SZ）等国产 MLCC 上市企业的投资机会。
- **风险提示：**1) 行业周期性波动风险；2) 市场竞争加剧风险；3) 技术研发与迭代不及预期

目录

1. MLCC 或迎来涨价周期	4
1.1 MLCC 具备容体比大、结构致密、介质损耗小等性能	4
1.2 全球 MLCC 涨价或将延续至 2026 年	5
1.3 国产 MLCC 重要企业：风华高科	7
2. 全球产业动态	10
2.1 NVIDIA 发布 2026 财年第四季度及全年财报	10
2.2 SK Hynix 与 SanDisk 正式启动存储器“HBF”全球标准流程	10
2.3 中微半导体发布 2025 年度业绩快报	10
2.4 ASML 计划将 EUV 光源提升至 1000W	11
2.5 Meta 与 AMD 签署 600 亿美元 AI 芯片协议	11
3. 本周市场回顾	12
3.1 SW 一级行业涨跌幅一览	12
3.2 SW 电子三级行业市场表现	13
3.3 SW 电子行业个股情况	13
3.4 SW 科技行业其他市场表现	14
4. 风险提示	15

图表目录

图表 1 : MLCC 结构构成.....	4
图表 2 : MLCC 与其他电容对比.....	4
图表 3 : MLCC 组成成本梳理.....	5
图表 4 : 全球 MLCC 市场规模.....	5
图表 5 : 中国 MLCC 市场规模.....	5
图表 6 : 2024 年全球 MLCC 主要企业市场份额.....	6
图表 7 : 村田、国巨、风华高科 2016Q1-2025Q3 销售毛利率统计.....	7
图表 8 : 风华高科营业收入及同比.....	8
图表 9 : 风华高科毛利率.....	8
图表 10 : 风华高科研发投入持续加码.....	8
图表 11 : 本周 SW 一级行业涨跌幅一览.....	12
图表 12 : 本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览.....	13
图表 13 : SW 电子个股本周涨跌幅前五.....	14
图表 14 : SW 电子个股本周涨跌幅后五.....	14
图表 15 : 本周费城半导体指数.....	14
图表 16 : 本周恒生科技指数.....	14
图表 17 : 本周中国台湾电子指数涨跌幅一览.....	15

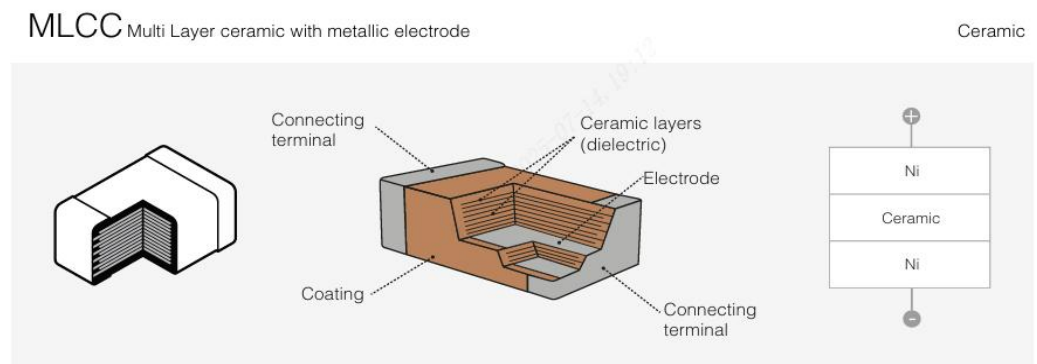
1. MLCC 或迎来涨价周期

事件：AI 带动的元器件涨价周期已从存储向核心被动元器件环节延伸。据韩国 The Elec 2026 年 2 月 24 日报道，全球重要 MLCC（多层陶瓷电容）厂商三星电机，正评估旗下产品的定价上调计划。MLCC 是电子电路中负责滤波、稳压、储能的核心基础元器件，韩国《Maeil Business Newspaper》分析指出，AI 服务器迭代带来的结构性高需求，是本轮 MLCC 涨价预期的核心支撑。

1.1 MLCC 具备容体比大、结构致密、介质损耗小等性能

MLCC 是电子整机中应用最广泛、用量最大的片式固定电容器。它由印刷有内电极（Electrode）的陶瓷介质膜片（Ceramic Layers）交替叠合层压，经高温共烧结合形成一体化陶瓷芯片体，再在芯片两端封接金属端电极（Connecting terminal），最终形成完整的瓷体电容器。

图表 1：MLCC 结构构成



资料来源：摩尔线程，爱建证券研究所

MLCC 以外，陶瓷电容还包含单层陶瓷电容器与引线式多层陶瓷电容器。单层陶瓷电容器即在陶瓷片两面制备金属层，再经光刻形成电极图形，其外形与安装方式与芯片类似。引线式多层陶瓷电容器则是将引线接合到片状多层陶瓷电容器的电极上，并在外部涂覆树脂封装后的产品。

图表 2：MLCC 与其他电容对比

类别	优点	缺点	应用
单层陶瓷电容器	体积小、频率特性好、适合于微组装工艺	容量小	高频电路中旁路、滤波等
引线式多层陶瓷电容器	容体比大、结构致密、介质损耗小、无极性、贮存方便、价格低，适合自动化插装	体积略大	旁路、滤波、谐振、耦合、储能、微分、积分电路
多层陶瓷电容器 (MLCC)	容体比大、结构致密、介质损耗小、无极性、贮存方便、价格低，适合表面贴装	容量低于电解电容器	各类防务、民用电子整机中旁路、滤波、谐振、耦合、储能、微分、积分电路

资料来源：宏明电子招股说明书，爱建证券研究所

在陶瓷电容中，MLCC 具备容体比大、结构致密、介质损耗小等优点，被广泛应用于各类防务、民用电子整机的旁路、滤波、耦合等功能，应用领域覆盖消费电子、汽车

电子等多个行业。

粉体圈数据显示，MLCC 成本主要由陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料、人工成本、设备折旧及其他构成。其中陶瓷粉末在 MLCC 的成本中占比较大，尤其在高容 MLCC 中成本占比可达 35%-45%。

图表 3: MLCC 组成成本梳理

组成成分	低容 MLCC	高容 MLCC
陶瓷粉料	20-25%	35-45%
内电极	5%	5-10%
外电极	5%	5-10%
包装材料	20-30%	1-5%
人工成本	10-20%	10-20%
设备折旧及其他	20-35%	20-30%

资料来源：粉体圈，爱建证券研究所

1.2 全球 MLCC 涨价或将延续至 2026 年

2022-2029 年全球 MLCC 市场规模整体呈现上升态势。中国电子元件行业协会数据显示，受益于全球消费电子需求回暖及新能源汽车高渗透率的双重驱动，2024 年全球 MLCC 市场规模达 1006.1 亿元，同比增长 5.0%。据中国电子元件行业协会预测，2025 年受益于 AI 服务器需求放量、车规级 MLCC 需求持续增加，全球 MLCC 市场规模或将达到 1050.43 亿元，同比增长 4.4%；到 2029 年全球 MLCC 市场规模将升至 1326.2 亿元，2025-2029 年间的复合增长率约为 6.0%。

中国作为全球重要的 MLCC 市场，2024 年其市场规模占全球比重达 52.5%。据中国电子元件行业协会数据，2024 年中国 MLCC 市场规模达 528.4 亿元，同比增长 7.0%；预计到 2029 年，中国 MLCC 市场规模将达到 671.8 亿元，同比增长 4.7%。

图表 4: 全球 MLCC 市场规模



资料来源：中国电子元件行业协会，宏明电子招股说明书，爱建证券研究所

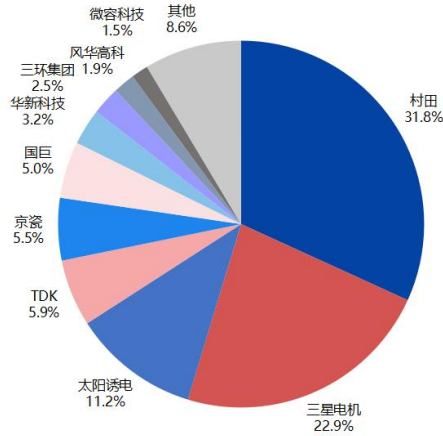
图表 5: 中国 MLCC 市场规模



资料来源：中国电子元件行业协会，宏明电子招股说明书，爱建证券研究所

从竞争格局看，全球 MLCC 市场仍由日、韩企业主导。据中国电子元件行业协会数据，2024 年全球 MLCC 市场份额前五的企业分别为村田 (31.8%)、三星电机 (22.9%)、太阳诱电 (11.2%)、TDK (5.9%)、京瓷 (5.5%)，合计占比达 77.3%。

图表 6：2024 年全球 MLCC 主要企业市场份额



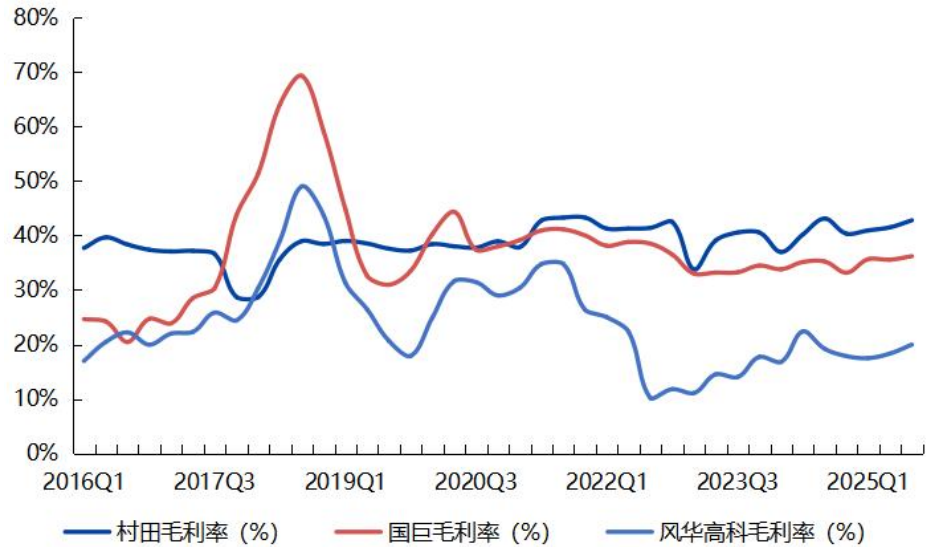
资料来源：中国电子元件行业协会，宏明电子招股说明书，爱建证券研究所

本文选取日本村田、中国台湾国巨、中国大陆风华高科进一步分析。通过梳理三家企业 2016Q1-2025Q3 的季度销售毛利率数据，我们发现：MLCC 行业具备较强的周期性特征，行业供需关系是企业盈利波动的核心驱动因素。

1) 2016 年起，随着日韩企业集中退出消费级 MLCC 市场、推进产能结构性转型，市场供给持续收缩，整体呈现供不应求的格局。国巨等台系企业与风华高科等大陆本土厂商，承接了日韩企业退出释放的市场空间，产品价格随市场供需缺口扩大同步上调。2018Q3，国巨和风华高科毛利率达到十年周期内的历史峰值，分别为 69.3%、49.01%。2019 年起，受前期扩产产能落地影响，行业供过于求，进入产能过剩的下行周期。

2) 2020-2023Q1，伴随 5G 与新能源汽车产业的快速发展，高端 MLCC 市场需求持续增长，行业进入新一轮上行周期。2021Q3，村田毛利率达到十年周期内的历史峰值，为 43.28%。2022 年起，受消费电子市场持续疲软影响，行业供需格局再度反转，自此进入下行周期。

图表 7: 村田、国巨、风华高科 2016Q1-2025Q3 销售毛利率统计



资料来源: 各公司公告, Wind, 爱建证券研究所

注: 数据来自 Wind, 截至 2026/2/25, 国巨、风华高科未披露 2025Q4 毛利率

村田 2021Q4、2022Q1、2023Q4 无对应自然季度的公开披露毛利率数据。为保证图表数据序列的完整性, 村田 2021Q4 销售毛利率以 2021Q3 已披露数值填充。

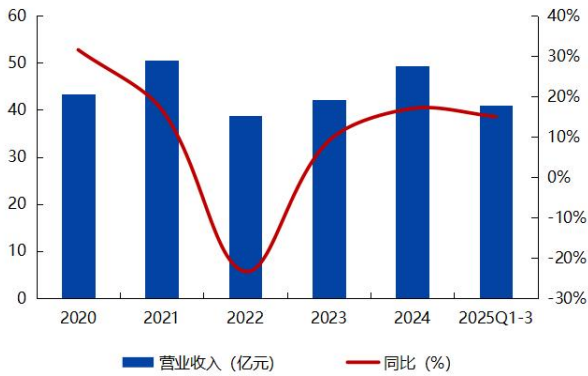
综上, 全球 MLCC 重要厂商毛利率自 2023Q3 起进入复苏通道, 本轮复苏节奏相对放缓。自 2024H2 起, 村田、国巨、风华高科公司毛利率整体呈现上升趋势。当前下游 AI 算力需求持续高景气, 行业供需格局持续优化, 2026 年 MLCC 市场涨价周期有望延续。

1.3 国产 MLCC 重要企业: 风华高科

风华高科是一家专业从事高端新型元器件、电子材料等电子信息基础产品研发、生产与销售的高新技术企业。公司主营产品包括 MLCC、片式电阻器、电感器、压敏电阻等, 产品广泛应用于包括汽车电子、智能终端、工业及控制自动化、家电、PC、新能源、AI 算力、无人机、储能、医疗等领域。

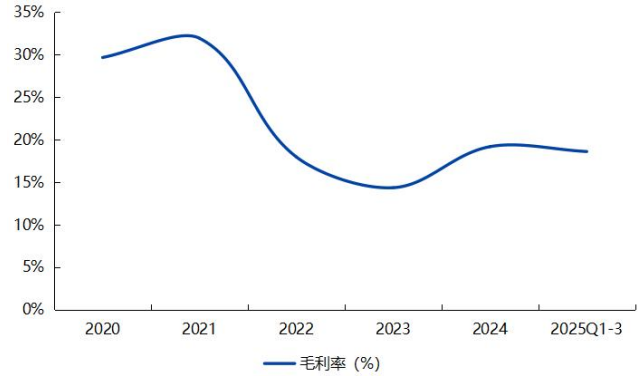
自 2023 年起, 风华高科营业收入保持稳步增长态势。2024 年公司实现营业收入 49.39 亿元, 同比增长 17.00%。2025Q1-3 公司营业收入达到 41.08 亿元, 同比增长 15.00%。盈利端同步改善, 2024 年公司综合毛利率达 19.17%, 同比提升 4.82 pct。

图表 8：风华高科营业收入及同比



资料来源：风华高科公司公告，爱建证券研究所

图表 9：风华高科毛利率

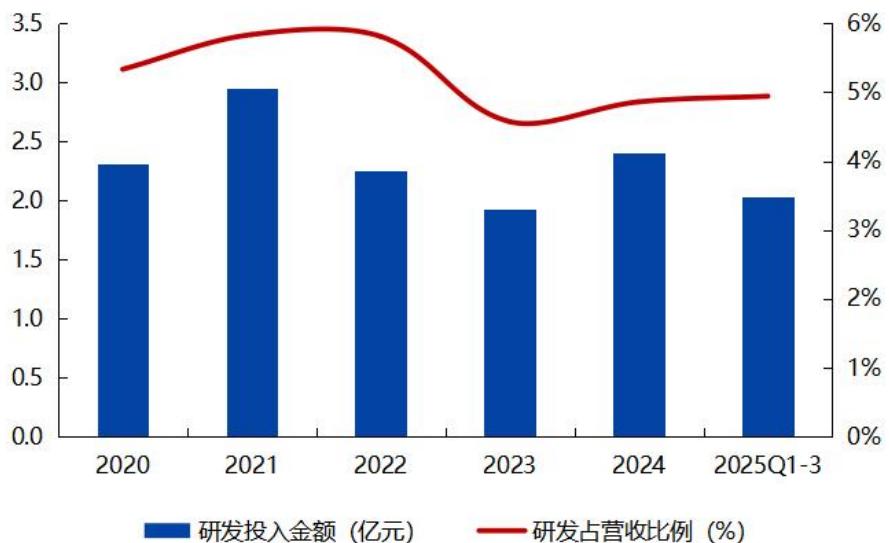


资料来源：风华高科公司公告，爱建证券研究所

公司研发投入持续加码，研发投入占营收比例稳定在 5%左右。2024 年公司研发费用达 2.40 亿元，同比增长 24.35%。依托高强度研发投入，公司在车规级 MLCC、高端元器件、核心材料三大领域均实现关键技术突破：

- 1) 公司车规产品核心技术实现关键突破，6 款高端车规 MLCC 完成战略客户认证，车规高压电阻通过 AEC-Q200 (全球汽车电子元器件强制准入标准) 认证并成功导入新能源车供应链，车规产品布局持续完善。
- 2) 公司 01005 超微型高频电感、车规一体成型电感完成研发并实现量产，叠层音频磁珠性能达到行业领先水平，车规大尺寸一体成型电感、车规共模电感研发成功，填补了公司相关产品空白，精密厚膜电阻完成研发，打破了日系厂商在高端精密电阻领域的长期垄断格局。
- 3) 公司攻克多项关键材料技术难题，纳米晶瓷粉、超细镍浆、车规电感软瓷粉等 9 款关键材料实现技术突破，核心性能指标优于进口材料。

图表 10：风华高科研发投入持续加码



资料来源：风华高科公司公告，爱建证券研究所

依托前期技术突破，公司全面聚焦高端赛道。风华高科祥和工业园高端 MLCC 基地一期已达产，三期产能持续释放并批量供货。针对小尺寸通用 MLCC 市场竞争加剧的现状，公司主动缩减祥和项目投资规模，终止以小尺寸 MLCC 为主的二期投资，提升资金使用效率。同时公司新增高端产能瞄准 AI、低空经济、智能机器人等新型科技领域，推动产业结构向高端化转型。

2. 全球产业动态

2.1 NVIDIA 发布 2026 财年第四季度及全年财报

美国时间 2026 年 2 月 25 日，NVIDIA 公布 2026 财年第四季度及全年财报。财报数据显示，NVIDIA 2026 财年第四季度营业收入达 681 亿美元，环比增长 20%，同比增长 73%；2026 财年全年总营收达 2159 亿美元，同比增长 65%，财年整体毛利率达 71.1%。

NVIDIA 数据中心业务呈爆发式增长态势。2026 财年第四季度，公司数据中心业务收入达 623 亿美元，2026 财年全年该业务累计收入达 1937 亿美元。报告期内，NVIDIA 推出了全新的 NVIDIA Rubin 平台，相较于前代 NVIDIA Blackwell 平台，该平台可将推理令牌成本最高降低 10 倍。亚马逊云科技 (AWS)、谷歌云 (Google Cloud)、微软 Azure (Microsoft Azure) 以及甲骨文云基础设施 (Oracle Cloud Infrastructure)，将成为首批部署基于 Rubin 架构产品的云厂商。

NVIDIA 其他核心业务板块表现同步向好。NVIDIA 游戏业务第四季度收入 37 亿美元，同比增长 47%，环比下降 13%；全年收入同比增长 41%，达 160 亿美元，创历史新高。汽车业务第四季度收入 6.04 亿美元，环比增长 2%、同比增长 6%，核心驱动为自动驾驶平台的规模化落地；全年收入同比增长 39%，达 23 亿美元。

业绩指引方面，NVIDIA 预计，2027 财年第一季度收入将达到 780 亿美元，上下浮动不超过 2%。

2.2 SK Hynix 与 SanDisk 正式启动存储器“HBF”全球标准流程

2026 年 2 月 26 日，SK Hynix 宣布：公司联合 SanDisk 举办“HBF 规格标准化联盟启动会”，正式发布面向 AI 推理时代的下一代存储器解决方案 HBF (High Bandwidth Flash, 高带宽闪存) 的全球标准化战略。

随着 AI 服务并发用户量（同一时间周期内，同时向 AI 系统发起推理请求、占用计算与存储资源的活跃用户数）快速增长，高速高效的存储系统已成为刚需。传统存储架构难以同时满足 AI 推理阶段海量数据处理与高能效的核心需求，而 HBF 正是为突破这一瓶颈推出的创新解决方案。作为介于 HBM 与固态硬盘之间的新型存储层级，HBF 的核心定位是弥合 HBM 高性能与固态硬盘大容量之间的技术差距，匹配 AI 推理场景对容量扩展性与能效的双重要求，并可与 HBM 实现深度协同。

此外，HBF 既能提升 AI 系统的扩展能力，也可有效降低系统总体拥有成本 (TCO)。

2.3 中微半导发布 2025 年度业绩快报

2026 年 2 月 24 日，中微半导发布 2025 年度业绩快报。2025 年公司实现营收 11.22 亿元，同比增长 23.09%；归母净利润 2.85 亿元，同比增长 108.05%。

报告期末,公司总资产 36.80 亿元,同比增长 11.19%;归属于母公司所有者权益 31.78 亿元,同比增长 6.16%。

业绩增长主要得益于持续研发投入与高端应用领域布局,叠加产品迭代、新品推广及综合服务能力提升。2025 年车规级芯片、工业控制芯片出货量快速增长,其中车规级芯片出货量同比增超 650 万颗、增幅约 73%;测量类产品市场份额稳步拓展,带动营收持续增长。

2.4 ASML 计划将 EUV 光源提升至 1000W

据 Wccftech 2026 年 2 月 24 日报道,ASML 计划将 EUV 光源功率从 600W 提升至 1000W。此次升级预计可使晶圆产能提升约 50%,且无需额外扩建无尘室或新增整套设备。

根据 ASML 披露,光源功率提升后,晶圆每小时扫描产出将从 220 片增加至 330 片,单位产出成本保持不变。这意味着晶圆厂仅通过设备升级,即可在现有产线与空间条件下实现显著产能增长,提升运营效率并优化资本支出配置。

实施策略方面,ASML 此前已向客户提供“生产力强化套件”(PEP),支持客户在不更换整机的情况下完成升级。但早期 NXE:3400C/D 型受限于热负载上限存在技术瓶颈,后续才逐步导入更高功率光源。本次 1000W 光源升级方案将优先适配较新的 NXE:3800E 系列,以及 High-NA EUV 机型 EXE:5000、EXE:5200。

2.5 Meta 与 AMD 签署 600 亿美元 AI 芯片协议

2026 年 2 月 26 日,Meta 与 AMD 签署 AI 芯片协议,计划未来五年采购价值 600 亿美元的 AI 芯片,部署总功率 6 吉瓦的计算设备。双方合作将采用 AMD Instinct MI450 GPU 及代号“Venice”的第六代 EPYC CPU,首批产品预计 2026 H2 交付。

AMD 将为 Meta 定制 AI 平台,双方联合制定技术路线图。AMD CEO 苏姿丰表示,该合作将提升 AMD 在 AI 领域的竞争力。

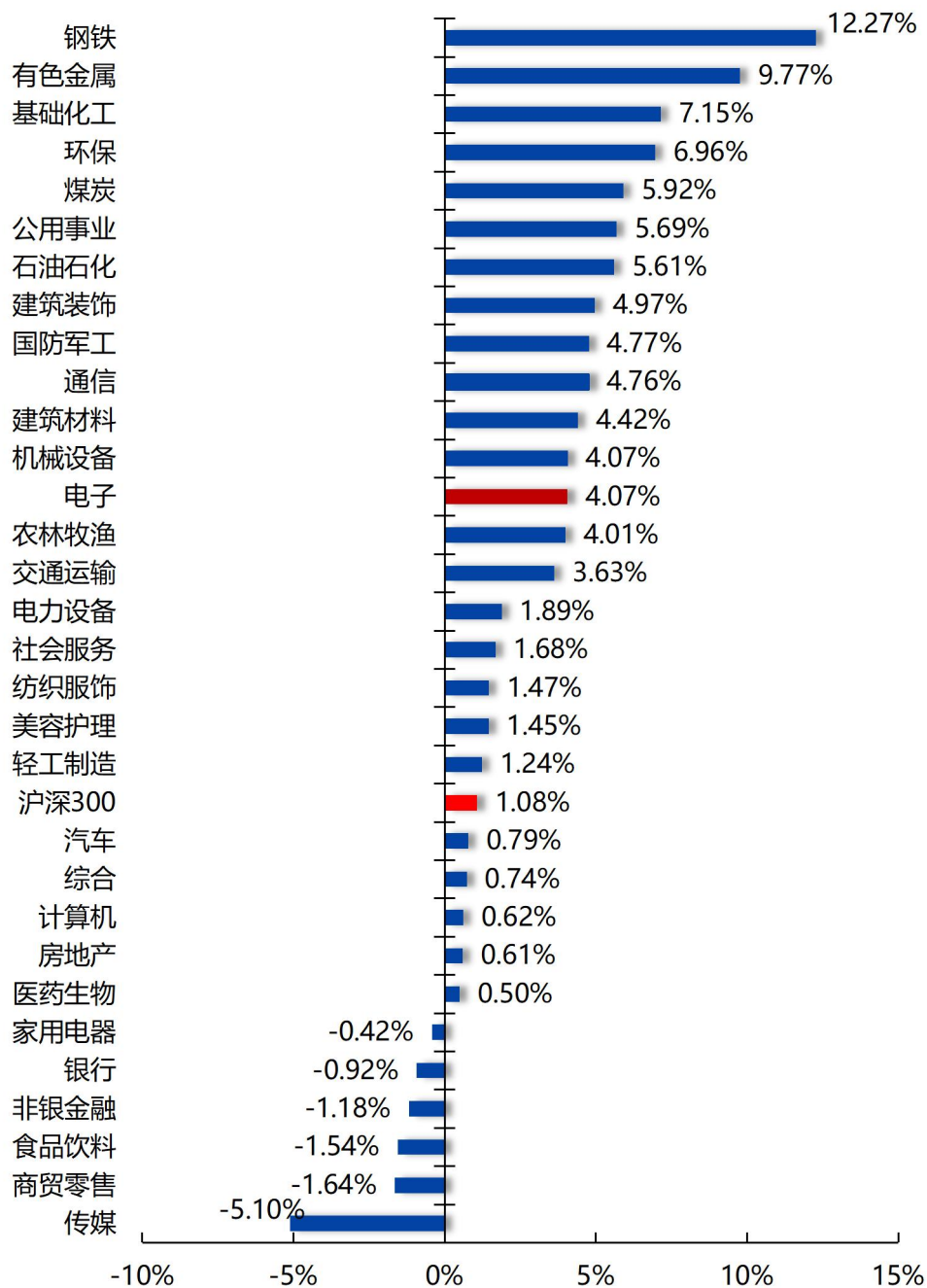
此外,AMD 向 Meta 授予业绩型认股权证,Meta 达成特定里程碑后,最高可获 1.6 亿股 AMD 普通股,成为其重要股东。

3. 本周市场回顾

3.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数(+4.07%)，涨跌幅排名 13/31 位，沪深 300 指数(+1.08%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：钢铁 (+12.27%)，有色金属 (+9.77%)，基础化工 (+7.15%)，环保 (+6.96%)，煤炭 (+5.92%)，涨跌幅后五分别为：传媒 (-5.10%)，商贸零售 (-1.64%)，食品饮料 (-1.54%)，非银金融 (-1.18%)，银行 (-0.92%)。

图表 11: 本周 SW 一级行业涨跌幅一览

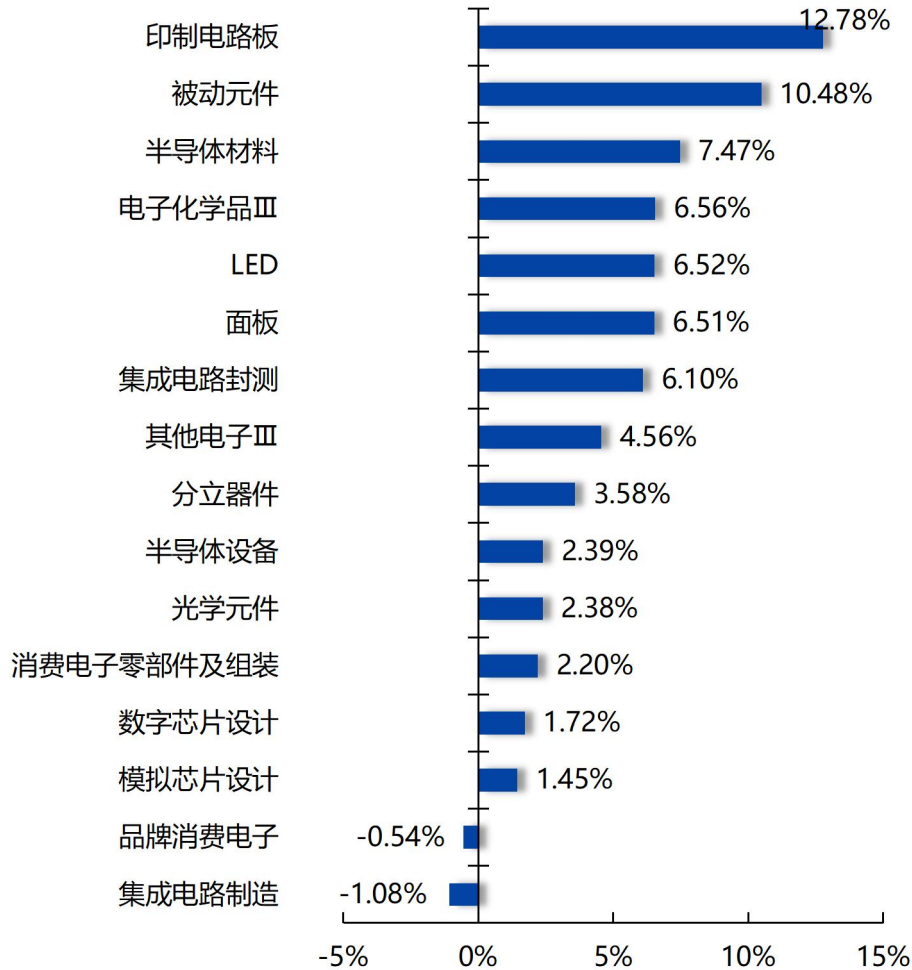


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：印制电路板（+12.78%），被动元件（+10.48%），半导体材料（+7.47%），涨跌幅后三分别是：集成电路制造（-1.08%），品牌消费电子（-0.54%），模拟芯片设计（+1.45%）。

图表 12：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



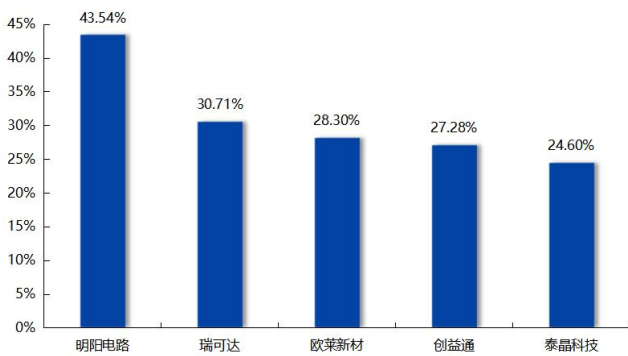
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：明阳电路（+43.54%），瑞可达（+30.71%），欧莱新材（+28.30%），创益通（+27.28%），泰晶科技（+24.60%）。

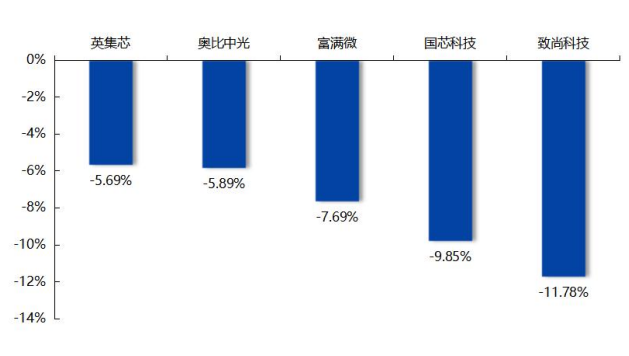
涨跌幅排名后五的股票分别是：致尚科技（-11.78%），国芯科技（-9.85%），富满微（-7.69%），奥比中光（-5.89%），英集芯（-5.69%）。

图表 13: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 14: SW 电子个股本周涨跌幅后五

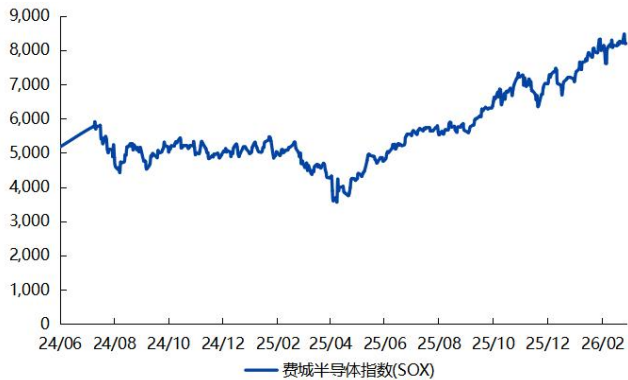


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为-1.96%，恒生科技指数本周涨跌幅为-1.41%。

图表 15: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

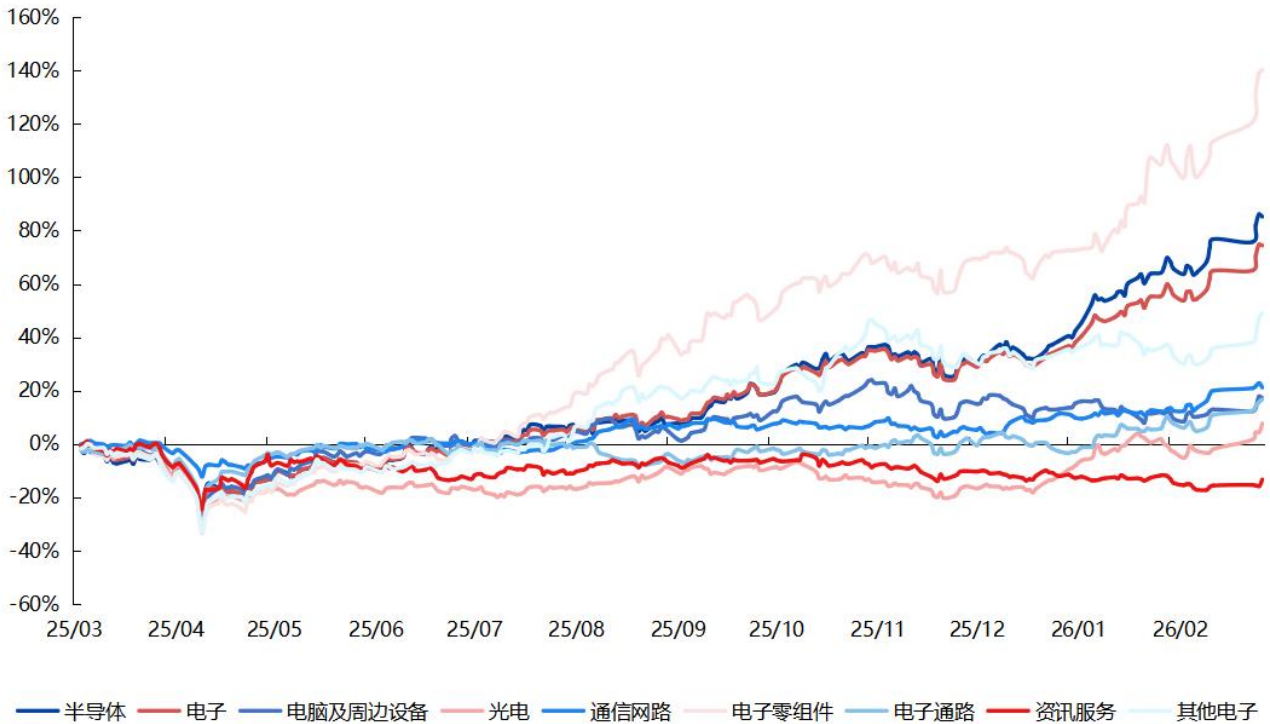
图表 16: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

截至 2026 年 2 月 26 日 (27 日台股休市) 中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是: 半导体 (+4.77%), 电子 (+5.75%), 电脑及周边设备 (+3.81%), 光电 (+9.83%), 通信网路 (+1.00%), 电子零组件 (+12.59%), 电子通路 (+5.28%), 资讯服务 (+2.70%), 其他电子 (+9.75%)。

图表 17：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所
注：2026.2.27 日台股休市

4. 风险提示

- 1) **行业周期性波动风险**：MLCC 行业具有周期性特征，供需格局变化易引发产品价格大幅波动。若未来 AI 算力等核心领域需求不及预期，或行业内厂商产能集中释放导致高端 MLCC 供过于求，可能出现产品价格持续下行的情况。
- 2) **市场竞争加剧风险**：全球 MLCC 市场长期由韩行业主导，其在高端产品领域具备显著的技术与客户优势，同时国内厂商亦在加速高端 MLCC 赛道的技术追赶与产能布局，市场竞争可能进一步加剧。
- 3) **技术研发与迭代不及预期**：MLCC 行业高端产品技术迭代快，研发投入高、量产与性能要求严苛。若后续核心技术研发、量产良率不及预期，或产品无法匹配下游迭代需求，将导致产品核心竞争力下滑。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；上交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。